

上海伟测半导体科技股份有限公司

2025 年度“提质增效重回报”行动方案

上海伟测半导体科技股份有限公司（以下简称“公司”）认为提高上市公司质量，增强投资者回报，提升投资者的获得感，是上市公司发展的应有之义，是上市公司对投资者的应尽之责，没有投资者的积极参与，资本市场的功能就不能得到有效发挥，上市公司就无法借助资本市场工具做大做强。只有更加突出以投资者为本，上市公司发展才是有源之水、有本之木。

为践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，维护公司全体股东利益，基于对公司未来发展前景的信心、对公司价值的认可和切实履行回报社会的责任感，公司特制定 2025 年度“提质增效重回报”行动方案，以进一步提升公司经营管理水平，进一步完善公司治理，强化市场竞争力，积极回报投资者，保障投资者尤其是中小投资者的合法权益，树立良好的资本市场形象。相关方案如下：

一、聚焦主营业务，实现高质量发展，以优异的业绩回报投资者

2024 年，受益于行业复苏、新客户导入、高强度研发投入、测试产品结构优化、产能利用率不断提高等原因，公司 2024 年营业收入逐季提升，并在第四季度创出单季度营收历史新高。2024 年全年实现营收 107,686.99 万元，较上年同期增长 46.21%。2025 年，公司将继续积极聚焦主营业务，提升科技创新能力，继续加大研发投入力度，不断提升测试服务质量，夯实市场领先地位，全面提升公司的核心竞争力、盈利能力以及行业内口碑，实现高质量发展，以优异的业绩回报投资者。具体包括以下几个方面：

（一）继续贯彻“以中高端晶圆及成品测试为核心，积极拓展工业级、车规级及高算力产品测试”的发展策略，积极把握国产替代及下游战略新兴行业的发展机遇，实现公司业绩快速增长

公司是第三方集成电路测试行业中规模最大的内资企业之一，主营业务包括晶圆测试、芯片成品测试以及与集成电路测试相关的配套服务。公司坚持“以中高端晶圆及成品测试为核心，积极拓展工业级、车规级及高算力产品测试”的发

展策略，聚焦高算力芯片（CPU、GPU、AI、FPGA）、先进架构及先进封装芯片（SoC、Chiplet、SiP）、高可靠性芯片（车规级、工业级）的测试需求，积极把握国产替代及上述战略新兴行业的发展机遇，实现公司业绩的快速增长，以优异的业绩回报投资者，致力于成为国内领先、世界一流的集成电路测试服务及解决方案提供商。

（二）积极推进募投项目，扩大测试产能，加快南京、无锡两个测试基地的“高端芯片”和“高可靠性芯片”测试产能的建设，为公司业绩的持续增长奠定产能基础

2024 年，公司围绕“以中高端晶圆及成品测试为核心，积极拓展工业级、车规级及高算力产品测试”的发展战略，继续扩大公司“高端芯片测试”和“高可靠性芯片测试”的产能建设，为未来业务增量提供产能保障。2024 年上半年，公司在南京的募投项目伟测集成电路芯片晶圆级及成品测试基地项目完成了厂房建设和配套设施的搭建，并于 7 月下旬完成竣工验收，设备进场，8 月份开始正式投产。在无锡的募投项目伟测半导体无锡集成电路测试基地项目于 2024 年 8 月全面启动建设，12 月完成主厂房封顶。

2025 年，公司将积极推进公司扩产计划，加码“高端芯片测试”和“高可靠性芯片测试”的产能建设，为我国集成电路测试的自主可控提供有力保障，助力我国人工智能、云计算、物联网、5G、新能源电动车、自动驾驶、高端装备等下游战略新兴行业的发展；同时，上述两个募投项目的实施将为公司业绩的持续增长提供产能保障，进一步巩固公司的行业地位，强化“高端芯片测试”和“高可靠性芯片测试”领域的差异化竞争优势，大幅度增加公司的测试服务能力、营业收入和高端业务占比，不断缩小公司与国际领先的独立第三方集成电路测试企业的差距。

（三）继续加大研发投入力度，为公司的快速发展提供技术支撑

2024 年，公司研发费用为 14,237.79 万元，较上年同比增长 37.16%，占营业收入的比重为 13.22%。2025 年，公司将继续加大高算力芯片、车规及工业级高可靠性芯片等领域的研发力度，在测试方案开发、底层测试技术突破、生产自动化等细分方向持续开展技术积累和技术突破，为公司的快速发展提供技术支撑。

公司采取阶梯式培养研发储备人员的培养方式，持续加大研发人员培养力度。截至 2024 年末，公司研发人员数量 458 人，占 2024 年末公司总人数的 23.94%，2025 年，公司将继续加大研发人员的内部培养和外部招聘，储备研发人才。

（四）积极开拓市场，不断提升市场占有率

公司现有客户已经超过 200 家，不乏国内知名的集成电路设计公司，以及部分晶圆厂、封装厂及 IDM 公司，经过数年发展，公司已与广大客户建立了长期稳定的合作关系，客户基础稳固。为广泛拓展市场、深挖潜在客户，公司 2024 年积极参与“上海集成电路 2024 年度产业发展论坛暨第三十届集成电路设计业展览会（ICCAD-Expo 2024）”进一步提升品牌曝光度，强化品牌形象，提升市场覆盖范围。公司通过参观“SEMICON/FPD China 2024”和“日本东京半导体展览会（SEMICON JAPAN）”等大型行业展销会并与行业内人士深度交流了解行业前沿技术。未来公司将继续加大市场的开拓力度，积极拓展境外客户，以更优质的测试服务、更高效的测试效率、更先进的测试水平提升公司在集成电路测试市场的占有率，更好地服务客户以及回报广大投资者。

二、完善公司治理，保障公司规范运作和可持续发展

2024 年，公司将根据新《公司法》及中国证监会、上海证券交易所下发的一系列法规规定的要求，对公司内部相关制度已完成修订和完善。2025 年，公司将持续完善公司治理能力建设和内部控制制度，按照新《公司法》和中国证监会新《上市公司章程指引》等要求，积极推进《公司章程》的修订和法人治理改革，持续完善公司现代法人治理结构和治理体系；促进规范运作，提升治理水平

2025 年，公司将及时向独立董事汇报经营情况和重大事项，并提交相关文件，为独立董事开展工作提供便利，切实保障独立董事的知情权，强化独立董事对公司的监督作用，深化独立董事制度改革，不断强化独立董事履职保障，发挥独立董事监督、决策和咨询作用，持续提高董事会的科学决策水平。

2024 年，公司董事、监事、高级管理人员均参与了由上海上市公司协会组织的“上海辖区 2024 年上市公司董事监事高管培训班”，各位独立董事参与了由上海证券交易所组织的“上市公司独立董事反舞弊履职要点及建议”专题的培训，

公司董事会秘书王沛完成了上海证券交易所 2024 年第 7 期上市公司董事会秘书后续培训，公司独立董事王怀芳完成了上海证券交易所 2024 年第 4 期上市公司独立董事后续培训。2025 年公司将继续积极组织董事、监事、高级管理人员参与上海证券交易所、上市公司协会及证监局组织的各类培训，加强学习证券市场法律法规，不断提升合规意识和风险意识，推动公司规范运作。

三、提高信息披露水平，加强投资者沟通，积极传递公司投资价值

2024 年，公司高质量完成四次定期报告和 75 次临时公告的披露，为投资者的价值判断提供了充分依据。报告期内，公司接听投资者热线 100 余次，回答 e 互动问题 20 余条，召开了 3 次业绩说明会，并组织了两次南京厂投资调研活动与投资者保持良好沟通，与投资者形成良性互动，及时听取投资者建议，回应投资者诉求。

2025 年，公司继续通过“上证 e 互动”、投资者热线、公司邮箱、业绩说明会、电话会、网上路演等形式与投资者充分沟通公司业务情况、财务数据及公司未来发展战略。2025 年公司计划举办不少于 3 次业绩说明会，通过组织投资者参观活动，邀请投资机构、分析师及有兴趣的投资者，现场参观公司的生产线、办公区域，更加直观、贴近感受公司的文化，组织公司高管和相关部门负责人与投资者进行沟通；通过积极参加各家卖方机构组织的策略会，与各类投资者进行面对面交流，并根据投资者需要，安排公司现场调研、反路演等多种形式的投资者沟通交流，深入了解投资者的实际诉求，并做出及时回应。

四、完善投资者回报机制，继续保持不低于 30% 的现金分红比率，提升公司投资价值

公司自 2022 年上市以来重视对投资者的回报，公司坚持实行持续、稳定的利润分配政策，公司重视投资者的合理投资回报，兼顾公司的可持续发展，根据公司的盈利情况、现金流情况以及未来发展战略规划等因素，制定合理的利润分配方案。公司在《公司章程》中明确了公司现金分红政策并严格执行，十分重视

对股东的投资回报收益。

2022 年度和 2023 年度，公司已累计派发现金红利超 1 亿元。公司董事会拟定的 2024 年度利润分配方案是：拟向全体股东每 10 股派发现金红利 3.4 元（含税），以 2024 年 12 月 31 日公司总股本为基数计算，本次利润分配合计派发现金红利 38,703,824.18 元，占 2024 年度实现的归属于上市公司股东净利润的 30.18%。该现金分红方案将在公司股东大会审议通过后实施。至此，公司将连续三年实现以现金方式分配的利润均不低于公司当年实现的归母净利润的 30%。

五、强化管理层与股东的利益共担共享约束

（一）制定与经营业绩相挂钩的高管薪酬政策

公司高级管理人员的薪酬政策与公司的经营情况相挂钩。公司高级管理人员薪酬由基本工资、绩效奖金和年终奖金组成，同时公司根据每月度的营业收入情况制定月度营业收入奖金。根据每月的公司经营情况，结合个人及主管部门的业务情况，确定高级管理人员的绩效奖金。绩效奖金及年终奖金均与公司业绩及个人绩效完成情况挂钩。2025 年，公司将不断执行并优化高级管理人员的薪酬与公司经营情况相挂钩的方案。

（二）通过业绩考核强化股权激励约束机制

2023 年和 2024 年公司均开展了限制性股票激励计划，实现公司高级管理人员及核心团队成员的利益和公司股东利益的捆绑，共同推进公司发展。激励计划均选取了营业收入作为公司层面业绩考核指标，公司对所有激励对象个人还设置了合理的绩效考核体系，能够对激励对象的工作绩效做出较为准确、全面的综合评价。上述激励计划有利于公司进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

2025 年，公司将在上述限制性股票激励计划对应归属期届满后根据公司和激励对象的实际情况审议相关限制性股票归属的议案。

本次“提质增效重回报”行动方案是基于目前公司的实际情况而做出的方案，未来可能会受到宏观政策调整、集成电路行业波动情况、二级市场环境等因素的影响，存在一定的不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

公司将在积极履行本行动方案的基础上，持续评估实施本方案的相关举措，努力通过优良的经营业绩、规范的公司运作、积极合理的投资者回报，切实履行上市公司的义务，承担作为上市公司的职责，努力回馈广大投资者的信任，实现公司的价值。

特此公告。

上海伟测半导体科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 29 日